天津金海通半导体设备股份有限公司

公司代码:603061 公司简称:金海通

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、现金分红:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元(含税)。截至2026年3月10日公司总股本60,000,000股,公司拟合计派发的现金分红总金额为22,800,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例12.92%。

2、资本公积转增股本:公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股。截至2026年3月10日,公司总股本为60,000,000股,本次以资本公积转增股本后,公司的总股本为87,000,000股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。本次转增通过"资本公积——股本溢价"科目进行转增。

如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本数量发生变动的,则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变,相应调整现金分红、转增股份总额,具体调整情况将另行公告,调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。

本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金海通	603061	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘海龙	蔡亚茹
联系地址	上海市青浦区嘉松中路2188号	上海市青浦区嘉松中路2188号
电话	021-52277906	021-52277906
传真	022-89129719	022-89129719
电子信箱	jhtdesign@jht-design.com	jhtdesign@jht-design.com

2、报告期公司主要业务简介

(1)所属行业

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备,根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020—2024),隶属于专用设备制造业(行业代码:C35);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),隶属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)细分子行业。

(2)集成电路行业发展情况

①集成电路行业简介

半导体本质是一种导电性可受控制、介于绝缘体至导体之间的材料。从产业视角,半导体产业是围绕半导体包括材料、性能、应用等,发挥其优势进行科学研究、技术开发、功能设计、生产制造,集成应用与系统实施的全体系的产业;从环节视角,半导体产业包括半导体材料研发与生产、半导体装备与工具的生产制造、半导体产品规划设计、半导体产品的生产及其全体系;从功能视角,半导体包括集成电路和分立器件。集成电路是半导体产业的核心,也是信息产业的基础和核心。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是计算机、家用电器、消费电子、工业自动化、通信、汽车电子、航天等诸多产业发展的基础,也是改造和提升传统产业的核心技术。按其功能、结构的不同,集成电路可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数模混合集成电路等。集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、封装测试等。

公司的主要产品为集成电路行业中封装测试用的测试分选机,主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备,分选机和探针台是分别将被测的芯片或晶圆与测试机的功能模块连接起来并实现批量自动化测试的专用设备。在晶圆检测环节,主要使用的测试设备为测试机和探针台,而在芯片设计验证、成品测试环节,主要使用的测试设备为测试机和分选机。

②集成电路专用设备行业简介

专用设备制造业是集成电路的基础产业和重要支撑,是完成晶圆制造和封装测试环节的基础,是实现集成电路技术进步的关键,在集成电路产业中占有极为重要的地位。集成电路生产线投资中设备投资占比较大,价值量较高。专用设备主要包含前道工序晶圆制造环节所需的光刻机、化学气相淀积(CVD)设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等;后道工序封装测试环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等;测试环节所需的测试机、分选机、探针台等。在晶圆制造环节使用的设备一般被称为前道工艺设备,在封测环节使用的一般被称为后道工艺设备。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术,具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。

③行业发展情况

公司主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征,这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。

在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下,2025年全球半导体行业延续增长态势,先进封装、AI及高性能计算等需求的增长给半导体设备带来广阔的市场空间。半导体行业协会(SIA)数据显示,2025年全球半导体销售额达到7,917亿美元,较2024年同比增长25.6%,创历史新高。此前世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场规模预计同比增长22.5%。上述驱动因素动能的持续释放,将推动未来几年全球半导体行业持续快速发展。

特别是随着先进封装、AI算力芯片等的发展,相关芯片测试的复杂度在攀升,芯片测试总耗时大幅提高,对高端测试资源的需求在快速增加;与此同时,相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面,对半导体测试分选设备提出了更高的要求。半导体测试设备公司已进入快速发展新阶段。

未来,集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工,为确保产品质量、生产效率和生产稳定性,半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合,提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发,产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时,测试任务的复杂性对分选机设备不断提出更高要求,测试分选机设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。

(3)公司主营业务情况

自成立以来,公司一直专注于全球半导体芯片测试设备领域,同时致力于以高端智能装备核心技术助力我国半导体行业发展,以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代。

公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售,客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业(半导体设计制造一体化厂商)、芯片设计公司等。公司的产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度,产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。

公司产品集成电路测试分选机在客户公司(半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业、芯片设计公司等)所分选的芯片涵盖汽车电子、消费电子、智能互联、5G、人工智能等领域中应用的芯片(公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为)。

(4)公司主要产品介绍

公司深耕半导体测试分选机领域,产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列等不同系列的测试分选机。

公司产品测试分选机涉及到光学、机械、电气一体化的创新集成,可以精准模拟芯片真实使用环境,并实现多工位并行测试,其UPH可达20,000颗,Jam rate低于1/200,000,可测试芯片尺寸范围可涵盖2*2mm至125*170mm,可模拟最低-55℃,最高200℃等各种极端温度环境。

(5)公司主要经营模式

①盈利模式

公司为客户提供集成电路测试分选专用设备及备品备件并获取收入和利润。报告期内,公司主营业务收入主要来源于EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、其他系列等各类型测试分选机产品及相关配件的销售。

②采购模式

公司采购采取询价方式,综合考虑供应商产品品质、价格、交付能力等多方面因素选择供应商。公司综合客户订单情况、行业趋势等因素,按照"以销定产"和"安全库存"的形式确定生产计划以及物料需求计划。公司根据每年的供应商交货良率进行评估,结合采购需求及供应商的产品质量和交货能力,与供应商协商询价比选,确定各供应商的采购数量和采购价格等,最终确定采购订单并执行采购。报告期内公司主要供应商保持相对稳定。

③生产模式

公司产品具有较强的定制化属性,公司主要实行"以销定产"和"安全库存"的生产模式,结合库存和市场情况安排生产计划,并采用核心产品自主生产、部分成熟产品委托外协的方式进行生产加工。

④销售模式

公司主要的销售模式有直销模式和代理模式,客户群体主要分布在中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等半导体研发、加工产业发达的国家和地区,其中,境内销售以直销模式为主,境外销售主要有直销和代理模式。对于直销模式与代理模式,主要由公司与终端客户直接签署销售合同。代理模式下,待客户验收设备并支付货款后,公司根据代理协议支付代理商相应佣金。公司具有完善的售后服务体系,公司在境内外设立了子公司或售后团队负责当地及周边客户的售后工作。

⑤研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司研发人员主要分为机械类、电气类、软件及算法类、工艺类等多个方向,研发工作按具体研发项目细分为不同项目小组分别进行。公司对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了相应规定。研发项目完成立项、审批程序后,形成技术方案;不同研发小组根据技术方案分别进行新产品相关模块的设计,并根据设计完成新产品制造,通过阶段性测试与综合测试之后,进行试生产验证。在实际生产环境测试中,研发小组成员会根据反馈持续完善产品性能,直至新产品正式定型,并投入量产。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,149,652,155.84	1,598,565,608.03	34.47	1,584,983,205.39
归属于上市公司股东的净资产	1,614,293,008.86	1,316,232,759.41	22.64	1,398,855,603.87
营业收入	698,176,005.39	406,666,312.61	71.68	347,234,545.48
利润总额	196,800,497.09	84,850,967.53	131.94	92,726,544.39
归属于上市公司股东的净利润	176,525,276.68	78,481,491.79	124.93	84,794,096.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,048,596.02	67,736,509.73	152.52	69,465,975.89
经营活动产生的现金流量净额	127,809,505.47	58,986,103.16	116.68	-48,361,309.85
加权平均净资产收益率(%)	12.22	6.01	增加6.21个百分点	6.84
基本每股收益(元/股)	3.05	1.35	125.93	1.47
稀释每股收益(元/股)	3.04	1.35	125.19	1.47

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	128,605,637.35	178,810,367.32	174,179,734.83	216,580,265.89
归属于上市公司股东的净利润	25,658,510.03	50,347,028.65	48,975,719.98	51,544,018.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,309,116.01	49,504,980.56	47,665,465.08	49,569,034.37
经营活动产生的现金流量净额	5,983,247.41	10,593,454.00	33,374,315.90	77,858,488.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,806
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
崔学峰	0	8,511,132	14.19	8,511,132	质押	2,550,000	境内自然人
宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	0	5,369,685	8.95	0	质押	1,680,000	其他
龙波	0	5,344,146	8.91	5,344,146	质押	530,000	境内自然人
南通华泓投资有限公司	0	3,958,890	6.60	3,958,890	无	0	境内非国有法人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-916,000	3,042,471	5.07	0	无	0	其他
钟格	590,000	2,870,000	4.78	0	无	0	境内自然人
天津金海通半导体设备股份有限公司-2025年员工持股计划	1,734,770	1,734,770	2.89	0	无	0	其他
南京金浦新潮创业投资合伙企业(有限合伙)	-677,400	1,719,953	2.87	0	无	0	其他
秦维辉	72,200	955,842	1.59	0	无	0	境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	727,781	734,581	1.22	0	无	0	境外法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、崔学峰、龙波为公司的控股股东、实际控制人,崔学峰与龙波为一致行动人;

2、上海瀚皖动投资有限公司作为有限合伙人持有上海金浦、南京金浦的财产份额,上海金浦、南京金浦还拥有共同的合伙人上海经视企业管理中心(有限合伙)、上海金浦新阳私募基金管理有限公司,上海瀚皖动投资有限公司;

3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

4.5股份债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-026

天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年3月18日(星期三)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2026年3月11日(星期三)至3月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")邮箱jhtdesign@jht-design.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年3月11日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,以及2025年年度利润分配情况,公司计划于2026年3月18日(星期三)15:00-16:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标、2025年度利润分配及资本公积转增股本方案等方面与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年3月18日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理崔学峰先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄浩女士和独立董事孙晓伟先生等(具体参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年3月18日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年3月11日(星期三)至3月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jhtdesign@jht-design.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:021-52277906

邮箱:jhtdesign@jht-design.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026年3月11日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-019

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月28日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事,会议补充通知分别于2026年3月6日、2026年3月9日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事7人)。

会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案获得通过。

(二)审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

本公司总经理崔学峰先生代表公司管理团队,对2025年度公司整体运营情况进行了总结,对公司未来的发展进行了讨论与分析,并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

此议案获得通过。

(三)审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

本公司董事长崔学峰先生代表公司全体董事,对2025年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结,对公司未来的发展进行了讨论与分析,并编制了《天津金海通半导体设备股份有限公司2025年年度董事会